

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2026-045

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于收到中国银行间市场交易商协会

《接受注册通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司分别于 2026 年 5 月 18 日、2026 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》，具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI14 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。《接受注册通知书》主要内容如下：

一、公司债务融资工具注册金额为 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由宁波银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，结合公司资金需求及市场情况，在有效期内择机实施债务融资工具的发行事宜，并履行信息披露义务。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日